

株式会社東京精密 2023年度(2024年3月期) 第1四半期 決算説明会
質疑応答 要約

2023年8月2日 開催

- 本資料は、上記日時に開催された2023年度(2024年3月期) 第1四半期 決算説明会(Web開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
- 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」と表記します。

1. 4-6月期 SPE受注高が想定を上振れた背景と、7-9月期予想(QoQ横ばい)の前提、ならびに下期の見通しを確認したい。
 - 4-6月期の上振れは、パワー半導体用途のグラインダ・プローバ、ウェーハ増産用途のグラインダ、アナログ半導体用途のプローバ需要が主因。
 - 7-9月期以降の見通しは、民生・OSATが年度一杯は軟調、生成AIやHybrid Bondingなどの研究開発投資が入るとの前提に立っている。これらにより、下期の受注は、1-3月期より多少増加する期待を持っている。
2. 一部のロジック半導体メーカーは、在庫調整の完了、7-9月期以降の業容改善を示唆しているが、当社SPEの受注回復には一定の時間を要すると想定しているのか?
 - OSAT顧客との対話を踏まえ、稼働率上昇にはもう少し時間を要すると想定している。
3. 4-6月期のSPE受注高に占めるパワー半導体ならびにSiC向けの比率を伺いたい。またこれらの持続性、受注を受けた場合の売上貢献時期の見通しを伺いたい。
 - 4-6月期の受注高におけるパワー半導体向けは約20%、SiCはその半分、約10%程度と推定。
 - 下期に向けても、高水準横ばいの需要を想定している。
 - また、現時点で受注を受けた場合、2024年度の売上に貢献するものと想定する。
4. 4-6月期の計測受注高に関して、補足で解説をいただきたい。

- 充放電試験システムが受託測定用途などで堅調な受注となったほか、汎用計測において、様々な商談がみられた。
5. 4-6 月期の SPE 売上高は概ね想定通りとのことだが、納期延伸の影響や、地域別動向(特に中国)について伺いたい。
- まず、受注済案件の出荷納期の関係から、上期売上高は 7-9 月期寄りの計画となっており、4-6 月期はほぼ想定通りの着地であった。
 - 4-6 月期は、民生用途を中心に 2 桁億円の納期延伸があった一方、パワー半導体などでの前倒し案件も同水準見られ、ネットで ほぼ想定通りとなった。
 - 地域別動向では、中国を含め、大きな変化は無かった。
6. 4-6 月期 営業利益の前年同期比増減について、セグメント別に解説いただきたい。
- SPE は前年同期比での減収、計測は同 増収が主因であり、研究開発費などを含めた人件費の増加の影響が一定程度あった。
 - また、為替により SPE を中心に約 1 億円の押し上げとなった。
7. 現在の部材調達、人財確保の状況について伺いたい。
- 部材逼迫は全般に緩和傾向だが、引き続き調達に時間を要する部材が存在する。
 - また人財については、飯能工場(埼玉県)の稼働に必要な人員は充足している。しかし今後の業況の変化によっては新たな採用等を検討することになる。
8. 現在のグラインダ生産能力について、先ごろ稼働した飯能工場の稼働状況を踏まえて解説いただきたい。
- グラインダ生産はフル稼働が続いている。飯能工場は、計画通り 7 月から稼働開始し、プローバの生産を八王子工場から移管している。具体的な時期の説明は控えるが、八王子工場に空いたスペースをグラインダ生産に転用する。
9. 現在の中国の SPE 需要環境について、日本政府が 7 月 23 日に施行した輸出管理規制の影響も踏まえて伺いたい。
- 当社の SPE には、輸出管理規制に該当する 23 品目と直接関係するものは無い。
 - 元より、需要家については、規制等に基づき厳格な調査を行っている。
 - また、施行日以降の事務作業増加も無い。
 - 一方で、中国からの発注は、他地域と比べ活況であることも事実である。市場の先行きを考慮する必要はあるが、規制の影響は概ねニュートラルに捉えている。
10. 会社は 2023 年度業績予想を据え置いているが、各事業の前提を若干変更している。

計測事業の前提変更について解説いただきたい。

- 計測の前提を、「自動車向けは ICE の緩やかな回復/NEV の急拡大を想定」から、「自動車向けは NEV の拡大」へ変更した。足許では、ICE の量産投資が軟調であり、今後の設備拡大の期待値も乏しい。また、自動車メーカ各社が相次いで EV 開発計画を公表し、より地に足がついた計画が見えてきたことで、当該前提を改めた。
- 計測事業において、自動車関連業界は主要顧客であり、ICE 投資の減少は業績予想にはマイナスとなる一方、EV、非自動車分野（オートメーションや、半導体、航空機、医療等）の事業機会を獲得することで、業績予想を達成する前提。

11. SPE の 2023 年度予想は、民生需要が軟調であっても、生産スロット調整により前倒しの案件を売り上げる前提か？

- その理解でよい。

12. 5 月説明会では、高精度温度制御プローバの需要拡大の期待を説明していた。現状はどうか。また生成 AI 等での事業機会が大きいという理解でよいのか。

- 高精度温度制御は、生成 AI 向けを含め、HPC 等、測定時に発熱量が増加するデバイス全般にニーズがあると考え。また、今後メモリ半導体でも、高精度温度制御の需要が高まると考えており、数字として表れるのはむしろメモリ半導体向けが早いと考える。

13. HBM や CoWoS 向けのグラインダの優位性、業績予想への織り込みなどを解説いただきたい。またこれらは 2.5D や Chiplet についても同様か。

- ハイエンドの積層化全般で、当社のグラインダに事業機会があると考え。顧客が求める加工速度や平坦度などの技術要求を満たす製品を提供できていると考える。なお、関連した製品に関する受注高は 1Q の実績や 2Q の見通しには含まれておらず、また 2023 年度の業績予想にも織り込んでいない。

14. HBM におけるプローバの事業機会をどう考えるか。

- HBM 等の積層化メモリにおいてもプローバの需要は発生するため、今後受注高に計上されてゆくと想定。

15. 生成 AI に関連したパッケージングや HBM に関して、具体的にどのような事業機会があり、また 2024 年度にはどの程度の規模になるのか改めて確認したい。またこれらがどのタイミングで受注に計上されるかを確認したい。

- 定量的な見通しは控えるが、Hybrid Bonding など、ロジック、メモリ双方にお

ける積層化が進むことによるグラインダ需要、メモリ、特に HBM 関連のプローバ需要を期待している。数字のイメージは控えるが、いずれも 1Q の受注高には含まれておらず、2023 年度の業績予想にも織り込んでいない。こういった説明会でコメントできる程度の期待値を持っているということをご理解いただきたい。

以上